

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年12月1日(01.12.2022)



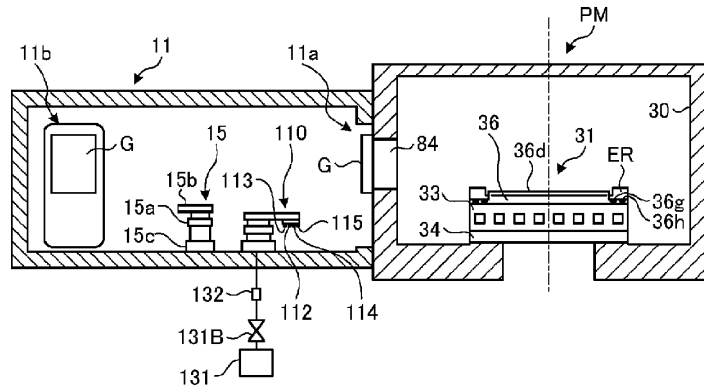
(10) 国際公開番号

WO 2022/250014 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/3065 (2006.01) *C23C 16/44* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/021104
- (22) 国際出願日: 2022年5月23日(23.05.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-088086 2021年5月26日(26.05.2021) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 道 菅 隆(DOKAN, Takashi); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).
- (74) 代理人: 弁 理 士 法 人 酒 井 国 際 特 許 事 務 所 (SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 虎の門三井ビルディング Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM AND MAINTENANCE METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理システム及びメンテナンス方法



(57) Abstract: A substrate processing system comprising a substrate processing device, a vacuum transport chamber, a transport mechanism, a suction mechanism, and a control unit. The substrate processing device includes a vacuum processing chamber in which vacuum processing is performed on a substrate. The vacuum transport chamber is connected to the vacuum processing chamber, and includes a transport opening that can be communicated with the vacuum processing chamber. The transport mechanism is disposed in the vacuum transport chamber to transport the substrate through the transport opening. The suction mechanism is disposed in the vacuum transport chamber adjacent to the transport mechanism, to suction a deposit on a component in the vacuum processing chamber through the transport opening. The control

[続葉有]

LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

unit controls the transport mechanism and the suction mechanism.

(57) 要約: 基板処理システムは、基板処理装置と、真空搬送室と、搬送機構と、吸引機構と、制御部とを有する。基板処理装置は、基板に対して真空処理が実行される真空処理室を有する。真空搬送室は、真空処理室に連結され、真空処理室と連通可能な搬送口を有する。搬送機構は、真空搬送室に配置され、搬送口を介して、基板を搬送する。吸引機構は、搬送機構と隣接して真空搬送室に配置され、搬送口を介して、真空処理室内の部品の付着物を吸引する。制御部は、搬送機構及び吸引機構を制御する。